

2024年度事業計画書

自：2024年4月1日 至：2025年3月31日

1. 学会運営

(1) 学会運営基本方針

以下の運営基本方針を継続する。

- ① 世界をリードする実装技術のけん引役としての活動
- ② 幅広い技術領域をカバーしていることを活かし展開
- ③ 将来を担う若い実装技術者の育成と魅力ある活動の場の提供

今年度はコロナ後の世界となり当学会も現地開催とオンラインのそれぞれの強みを生かしたハイブリッド開催を実施していくことを基本にする。MES2024、第39回春季講演大会、公開研究会、教育事業をハイブリッドで開催することにより、参加方法の選択肢が増え、各イベントへの参加がしやすくなり、より多くの方々へ情報発信が可能となり学会活動が活性化していくことを期待する。また、半導体の微細化による性能向上に陰りが見える中、新たな差異化領域として後工程（パッケージング）技術が注目されている。当学会も3Dチップレット研究会を中心に各研究会で先端技術を広め、社会の発展に寄与すべく体制を整備していきたいと考えています。また、教育という場面でも、今後の日本を担う若手技術者への実装技術の継承を進めるために新たな教育講座を新設していく予定。今後も人と人との直接的な繋がり の機会を提供するとともに、オンライン活用により多くの人への最新情報を提供できるような活動を積極的に展開することを目指す。

(2) 総務委員会

学会運営の持続可能性を確保するために、さまざまな改革が必要である。事務局員のスキル向上はもちろん、デジタル環境の導入も積極的に実施していく。また、学会が保有する「情報資産」を社会に還元し多くの人々に展開する方法を今後検討していくことも重要である。

(3) 財務委員会

今年度の予算については、昨年度から好調に推移しており、参加者の継続的な参加を得るために現地開催とオンラインによるハイブリッド開催を継続していく。さらに、環境を整備し、より良い環境を提供するために各種運営改善も実施していきます。これにより、多くの参加者を獲得し学会全体の収益改善を実現させ、会員および関係者へのサービス向上を目指す。

(4) 広報委員会

学会からの情報発信を、公共向け、会員向けを更に強化していく。他学会との連携も視野に入れ、より多くの社会の認知度向上及び会員への情報サービス向上を図り、会員増強、イベント集客に繋げていく。また、海外向けホームページが完成したことにより、新たに海外からの各社イベントへの参加、論文投稿の増加を積極的な展開を行う。学会の国際的知名度向上のために国際事業委員会と連携し学会の国際的な知名度向上を推進する。

(5) 会員増強委員会

大会事業、展示会運営委員会、技術調査事業、教育事業、支部事業の各イベント開催を通じ会員増強活動を実施する。新規入会優遇キャンペーンを継続しより多くの会員獲得を目指していく、特に学生会員、若手会員の勧誘に力を注いでいきたい。

(6) ミッションフェロー活動

設立10ヶ年を経て、講演大会およびMESにおけるミッションフェローセッションが定着してきた。新たなメンバーも加わり、学会活性化、会員増強に向けた、新規企画を継続的に

【第3号議案】

検討する。

(7) JPCAとの連携

JPCAとJIEPは極めて重要なパートナーである。JPCA Showを起点に定期的な情報共有を行い、お互いの強みを活かし発展、成長させる。更に、JPCA会員に向け学会会員価格を設定し学会で実施している教育事業、公開研究会等の積極的な参加を促すことを継続する。

2. 大会事業活動（定款第4条第1号関係）

春季講演大会、秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES）、国際会議 ICEP、ワークショップを実施します。これらのイベントへの参加者および発表者の増加を図るため、各行事を現地参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリット型で実施していく。また、各大会の連携を強め、継続的な情報提供を強化し、更に新分野のセッションの企画などを強化していく。また、各大会の継続的な実施を図るためのステアリング委員会を整備していく。

(1) 「国際会議 ICEP2024」

2024年4月17日～20日に現地（富山国際会議場）で開催する。年初に起きた地震の影響がまだ残る中、世界から多くの参加をいただき実装技術の最新情報を発信していきたい。今大会の論文投稿数は過去最多となり多くの研究者、聴講者が参加することを見込んでおり、各方面での意見交換ができると期待している。

(2) 「第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2024」

2024年9月11日～13日 大同大学（名古屋市）現地会場とオンライン配信とのハイブリットでの開催を実施する。今回は口頭発表に加えポスターセッションを新設し、実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新の研究・開発の成果発表と情報交換の場を提供していく。スマートプロセス学会との連携、特別講演の企画、各種のオーガナイズドセッションなどを充実し、多くの参加を期待している。

(3) 2024ワークショップ

修善寺WSは2024年10月10日～11日に、昨年に引き続き修善寺での現地開催を計画している。実装技術、関連技術について、発表者と参加者と双方向のディスカッションにより理解を深めることができるイベントとして提供する。

(4) 「第39回春季講演大会」

2025年3月11日～13日拓殖大学文教キャンパスにて現地とオンライン配信のハイブリッド開催を予定している。実装分野の企業・大学・公共研究機関の新技术開発の発表と情報交換の場を提供する。特別講演はもとより、企業展示によるものづくり技術の紹介、チュートリアルセッションにより若手研究者の参加者増も図り、より多くの方に参加いただき実装技術情報共有の場を提供する。

3. 展示会運営委員会活動（定款第4条第1号関係）

JPCA Show と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、及び、eX-tech を6月12日～6月14日 東京ビッグサイト東館で実施する。eX-tech、アカデミックプラザのブース展示についても同時開催する。

SEMICON JAPAN 2024 12月11日～13日東京ビッグサイト への展示を予定。3Dチップレット研究会ブースは会場正面付近を予約済み、広く学会活動のアピールを予定している。

4. 技術調査事業活動（定款第4条第2号関係）

技術委員会および研究会は、学会の基盤活動を担っており、その活動を強化し活性化させることを目指し、前年に引き続き、技術委員会と研究会の活動について学会内外に発信し研

【第3号議案】

研究会同士の連携を促進し、学会外や学会以外との交流を通じて活動を活性化させることを目指しています。AI、IoT、ロボット&ドローン、ビッグデータなど、今日のテクノロジーの世界は急速に進化している。このような変化の速い時代において、新たな知識や技術を積極的に取り入れ、時代の変化に適応することが成功の鍵となる。当委員会は、対面活動とオンライン活用の両方の利点を最大限に活かし、最新情報を迅速に発信できる環境を整備し、拡充させていくことを目指す。

(1) 技術委員会の活動

11 の技術委員会を組織、実装技術分野の技術動向を調査しそれらの成果をまとめて学会誌特集号に掲載する。また、大会事業や展示会事業に委員を派遣し、各イベントの企画運営を支援します。さらに、教育事業委員会と連携し、実装教育の充実にも協力していく。

(2) 研究会の活動

現在の24研究会では、エレクトロニクス実装技術領域の環境変化に対応しつつ活動を展開する。基礎要素から応用までの幅広い実装関連テーマについて、委員同士が技術情報を交換し、情報共有の場を提供する。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果を公開研究会や学会誌等で広く公開していく。

(4) 情報提供方法について

これまでの現地参加型の公開研究会とオンライン配信を組み合わせたハイブリッドの実施を推進する。同じ場所に集まり情報交換の形式とともに、遠隔地からも参加しやすい環境を整備することにより、様々な情報が場所を問わず共有できる方法を充実させる。

5. 教育事業活動（定款第4条第3号関係）

将来を担う実装技術者、若手技術者を育成するために極めて重要であり、学会の果たすべき重要な役割である。

(1) 教育講座

「PWB製造初級講座」と各種実装教育講座を実施し、実装分野の研究開発者の育成に寄与します。また、技術運営委員会の協力を得ながら「実装技術総合基礎講座」をリニューアルし、講座の立ち上げを実現する。

(2) 教育セミナー

公開研究会では、取り上げにくいテーマで、実装関連のセミナーを平易に解説する「実装」セミナーと、実装だけではなく、実装環境を取り巻く様々な問題を解説するセミナーも実施を検討する。

(3) 実習付き教育講座

実習付き教育講座については、演習時間を充実確保するなどカリキュラムを工夫して、継続実施する。また、テーマについても、「伝熱解析の基礎と演習」「AI2oT講座の開設（電子工学的AI実装）」の2講座を予定している。

6. 会誌発行委員会活動（定款第4条第4号関係）

学会活動のアウトプットとして重要であり、例年通り学会誌を7回、英文論文誌を1回発行する。今年度は、前年度に実施した論文の早期公開と電子化を継続的に実施する。また、会員アンケートを実施することで会員の要望や希望を把握し実現に向けて検討する。英文論文誌は、海外への情報発信を強化するため電子閲覧での一般公開を継続、英文誌発行に先立って論文ごとに準備が整いしだい公開し査読完了から公開までの期間を短縮することを図る。

【第3号議案】

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を7回発行する。研究開発活動の成果として研究論文、総合論文、速報論文、解説等を掲載し実装技術に関する最新情報を会員に提供する。学会主催の大会行事で発表した論文に対し積極的に学会誌への掲載を勧誘する等、論文数の減少に歯止めを掛ける。また、理事会はじめ学会活動状況についても情報発信をしていく。

(2) 英文論文誌の発行

本学会の国際的な認知とプレゼンスの向上を図るため引き続き英文論文誌(Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.16-17)を発行する。電子閲覧を基本とし、学会ホームページ及びJ-STAGE(科学技術振興機構の総合電子ジャーナルプラットフォーム)から一般閲覧できるようにし、海外への情報発信を活性化していく。

さらに、英文ホームページより広く論文投稿を実施できる環境を整備していく。

(3) 日経テクノロジーオンラインへの抜粋版掲載

日経テクノロジーオンラインへの抜粋版掲載を継続する。海外への情報発信と技術普及を促進する。

(4) 収支改善

会誌発行事業の収支改善に向けた対策も急務である。電子化により広告等の掲載が減少しているため他の方法で広告を取り込む検討を行い新たな収入源を確保していく。

7. 国際事業活動(定款第4条第5号関係)

国際会議 ICEP を機軸に、IEEE EPS Japan Chapter, IMAPS との連携を継続する。また、パンパシフィック SMTA との情報交換も行い、日本で開催される国際学会との連携も含めて、関係強化を図っていく。これまで同様、IAAC(IMAPS All Asia Conference)を通じて、台湾、韓国との関係強化を進める。さらに、ASEAN 地域における学会活動拡大を念頭に、日系法人を中心にセミナー協力、技術情報提供など会員獲得を始める。

(1) 国際会議 ICEP2024

IEEE EPS Japan Chapter、IMAPS、IMPACT との連携、IEEE EPS Japan Chapter、IMAPS と、MOU 締結の手続きを行う。

(2) 国際事業体制

ICEP 開催に関して、ICEP Steering Committee を開催し数年先を見据えた体制を構築する。また、他の日本で開催される国際学会との連携も含め新たな仕組を構築する。

(3) ASEAN 地域における学会活動展開

ベトナムなど ASEAN 地域における学会活動拡大を図る。英文ホームページにより今後日系法人を中心に会員獲得を進めるとともに、セミナー協力、技術情報提供など現地活動への協力を行う。

8. 支部事業活動(定款第4条第6号関係)

支部の主体性を尊重しつつ活動を推進していく。関西支部、九州支部、北海道・東北支部も以下の独自イベントを実施していく。また他機関との共催で企画し支部会員の情報交流の場を提供するとともに産業界・大学と連携する活動を行う。

(1) 関西支部の活動計画

実装フェスタ関西 2024(2024年7月4日5日開催)、若手研究会セミナー(開催日未定)、技術講演会(開催日未定)、ぷらっと関西(開催日未定)のイベントを実施します。実装フェスタ関西 2024 は、現地での開催のみで行い、この機会に経験豊かな先輩と対面してナイ

【第3号議案】

トセッションなどを企画し、多くの方々が情報共有できる場を提供していく。

(2) 九州支部の活動計画

九州支部の独自イベントとして、講演会などを他機関との共催で企画し、支部会員の情報交流の場を提供するとともに産業界・大学と連携する活動を展開していく。

(3) 北海道・東北支部の活動計画

北海道・東北地区の会員増強のために、宮城県との共催セミナーの実施、更に技術運営委員会と共催し北海道・東北地区でセミナーを実施する事で積極的な学会のPR活動等を行う。今年度から新たに支部独自のセミナーの実施を計画中。7月9日に仙台でナノテラス見学会と半導体セミナーを計画している。

9. 表彰委員会活動（定款第4条第6号関係）

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーションの向上のため、例年通り、エレクトロニクス実装に関する学術の発展および学会活動に対して功績のあった方に学会賞、功績賞、技術賞、論文賞、功労賞、およびマイスター賞を贈呈する。ICEP、大会事業、秋季大会 MES、春季講演大会についても、例年通り優秀発表者を表彰する。